

导热硅脂 RH-TSG-5586

特色:

- 高导热、低 BLT、低热阻
- 低挥发分，挥发性环体<300PPM
- 高热稳定性，耐热冲击循环
- 不需要固化
- 无溶剂配方

产品组成

- 硅油
- 无机导热填料

产品应用

- 通用性导热硅脂，如计算芯片，服务器等。
- 集成电路模块 PCB 导热
- 游戏机、充电器等设备中的微处理器热传导

常见性能参数*

产品名称	RH-TSG-5586
导热率（瞬态法）W(m·K)	5.0 ± 0.1
热阻 °C-cm ² /W	< 0.05
粘度, mPa.s	700000
单组分 颜色	灰
密度 g/cm ³	3.0 ± 0.1
介电强度, KV/mm	< 2
挤出率 g/min	>20

应用方法

- 通用型自动点胶机等

运输储存条件

单组分包装:

- 600ml 塑料罐装，20L 铁桶包装
- 低于 45 摄氏度运输
- 常温保存，最佳使用期限为 6 个月以内

产品应用温度

通常有机硅材料在很大温度范围内保持稳定，考虑到综合性能和老化影响，此系列 -25 至 150 摄氏度范围内使用可获得最佳效果。如需其他温度范围，请咨询应用工程师。

其他注意事项

- 使用表面需保持清洁
- 如需返工，再次使用前需清洁表面
- 长时间放置可能会有少量硅油成分析出，建议搅拌后使用
- 避免人体皮肤直接接触